

中微半导体设备(上海)股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年3月30日
(二)会议召开地点:上海浦东新区张江路111号中微公司总部

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、独立董事意见
(一)独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见,认为该预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、监事会意见
(一)监事会认为,公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、备查文件
(一)第二届监事会第四次会议决议

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配政策
(一)利润分配原则
(二)利润分配政策

二、2021年度利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案实施日期

三、独立董事意见
(一)独立董事对本次利润分配方案发表了独立意见,认为该方案符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、监事会意见
(一)监事会认为,公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、备查文件
(一)第二届监事会第四次会议决议

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于 预计2022年年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
(二)日常关联交易履行的审议程序

二、日常关联交易履行的审议程序
(一)独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见,认为该交易符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、监事会意见
(一)监事会认为,公司2021年度日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
(一)第二届监事会第四次会议决议

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于 首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
(二)募集资金使用进度

二、募投项目结项情况
(一)募投项目结项原因
(二)募投项目结项程序

三、节余募集资金永久补充流动资金
(一)节余募集资金金额
(二)节余募集资金用途

四、独立董事意见
(一)独立董事对本次节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见,认为该事项符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、监事会意见
(一)监事会认为,公司本次节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规及公司章程的规定。

六、备查文件
(一)第二届监事会第四次会议决议

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2021年度日常关联交易公告

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计, 占同类比例, 上年实际, 占同类比例, 本次预计金额, 比上年实际增加/减少金额.

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
(二)日常关联交易履行的审议程序

二、日常关联交易履行的审议程序
(一)独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见,认为该交易符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、监事会意见
(一)监事会认为,公司2021年度日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
(一)第二届监事会第四次会议决议

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于 首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
(二)募集资金使用进度

二、募投项目结项情况
(一)募投项目结项原因
(二)募投项目结项程序

三、节余募集资金永久补充流动资金
(一)节余募集资金金额
(二)节余募集资金用途

四、独立董事意见
(一)独立董事对本次节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见,认为该事项符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、监事会意见
(一)监事会认为,公司本次节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规及公司章程的规定。

六、备查文件
(一)第二届监事会第四次会议决议

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于 首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
(二)募集资金使用进度

二、募投项目结项情况
(一)募投项目结项原因
(二)募投项目结项程序

三、节余募集资金永久补充流动资金
(一)节余募集资金金额
(二)节余募集资金用途

四、独立董事意见
(一)独立董事对本次节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见,认为该事项符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、监事会意见
(一)监事会认为,公司本次节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规及公司章程的规定。

六、备查文件
(一)第二届监事会第四次会议决议

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于 首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
(二)募集资金使用进度

二、募投项目结项情况
(一)募投项目结项原因
(二)募投项目结项程序

三、节余募集资金永久补充流动资金
(一)节余募集资金金额
(二)节余募集资金用途

四、独立董事意见
(一)独立董事对本次节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见,认为该事项符合相关法律法规及公司章程的规定。

五、监事会意见
(一)监事会认为,公司本次节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规及公司章程的规定。

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于 续聘 2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
(二)办公地点

二、聘任会计师事务所的独立性
(一)独立性
(二)诚信记录

三、聘任会计师事务所的胜任能力
(一)人员配备
(二)业务经验

四、聘任会计师事务所的收费
(一)收费标准
(二)收费方式

五、聘任会计师事务所的审计意见
(一)审计意见
(二)审计范围

六、聘任会计师事务所的审计程序
(一)审计程序
(二)审计时间

七、聘任会计师事务所的审计费用
(一)审计费用
(二)费用支付

八、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

九、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十一、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十二、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十三、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十四、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十五、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十六、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十七、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十八、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十九、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十一、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十二、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十三、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十四、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十五、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十六、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十七、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十八、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十九、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于 续聘 2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
(二)办公地点

二、聘任会计师事务所的独立性
(一)独立性
(二)诚信记录

三、聘任会计师事务所的胜任能力
(一)人员配备
(二)业务经验

四、聘任会计师事务所的收费
(一)收费标准
(二)收费方式

五、聘任会计师事务所的审计意见
(一)审计意见
(二)审计范围

六、聘任会计师事务所的审计程序
(一)审计程序
(二)审计时间

七、聘任会计师事务所的审计费用
(一)审计费用
(二)费用支付

八、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

九、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十一、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十二、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十三、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十四、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十五、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十六、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十七、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十八、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

十九、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十一、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十二、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十三、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十四、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

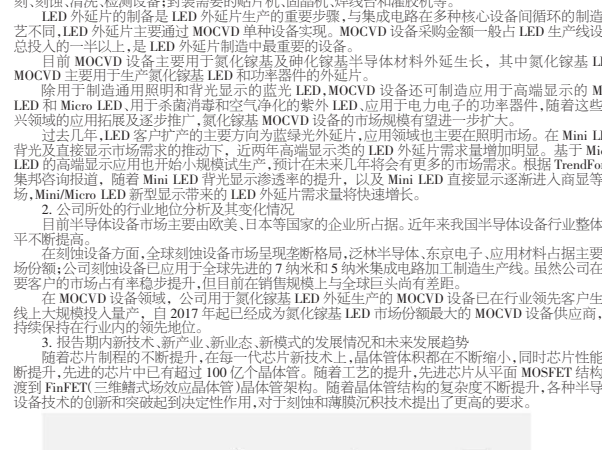
二十五、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十六、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十七、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十八、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称

二十九、聘任会计师事务所的审计机构
(一)审计机构
(二)机构名称



Microelectronics components: Planar FET, FinFET, GAAET (nanowire), and MBCFET (nanosheet).

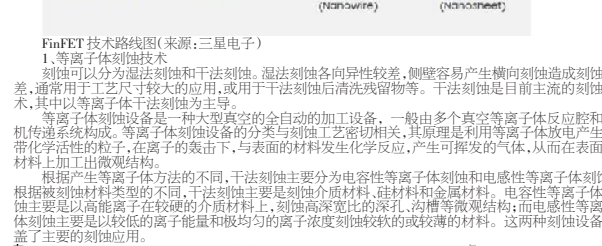


Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.



Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.

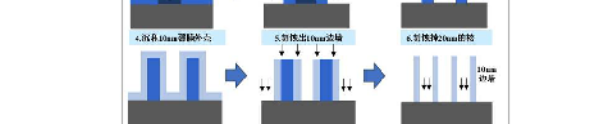


Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.

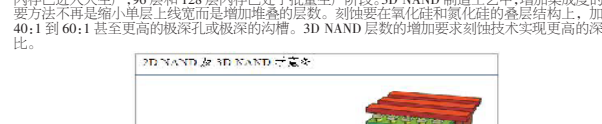


Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.

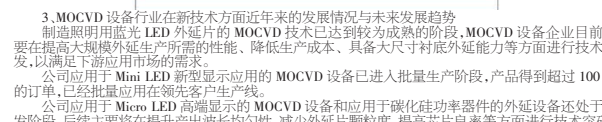


Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.

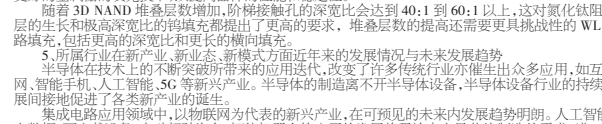


Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.



Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.



Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.

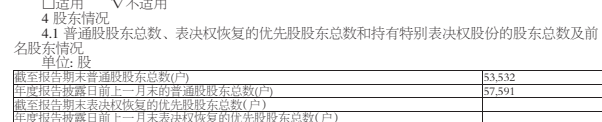


Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.

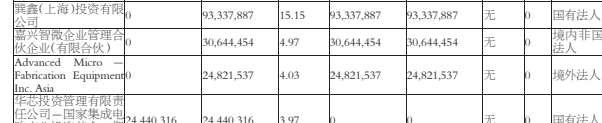


Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.

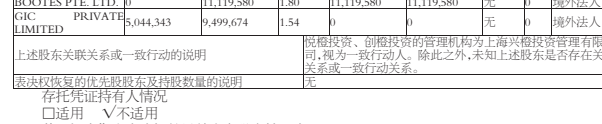


Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.

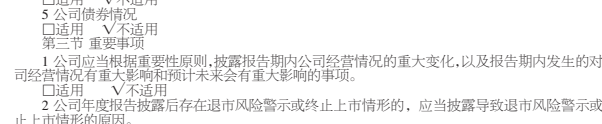


Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.

Diagram of a semiconductor device structure showing layers and components.